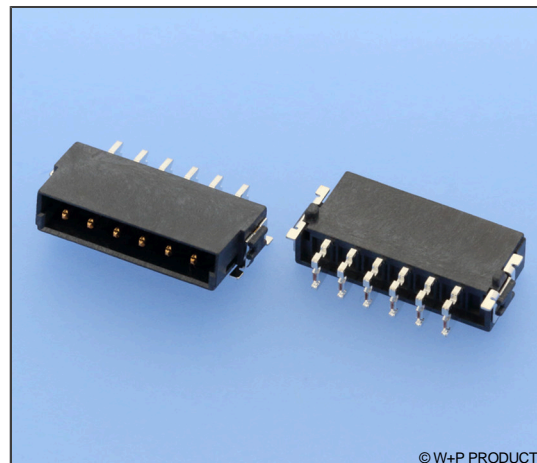


### Technische Daten / Technical Data

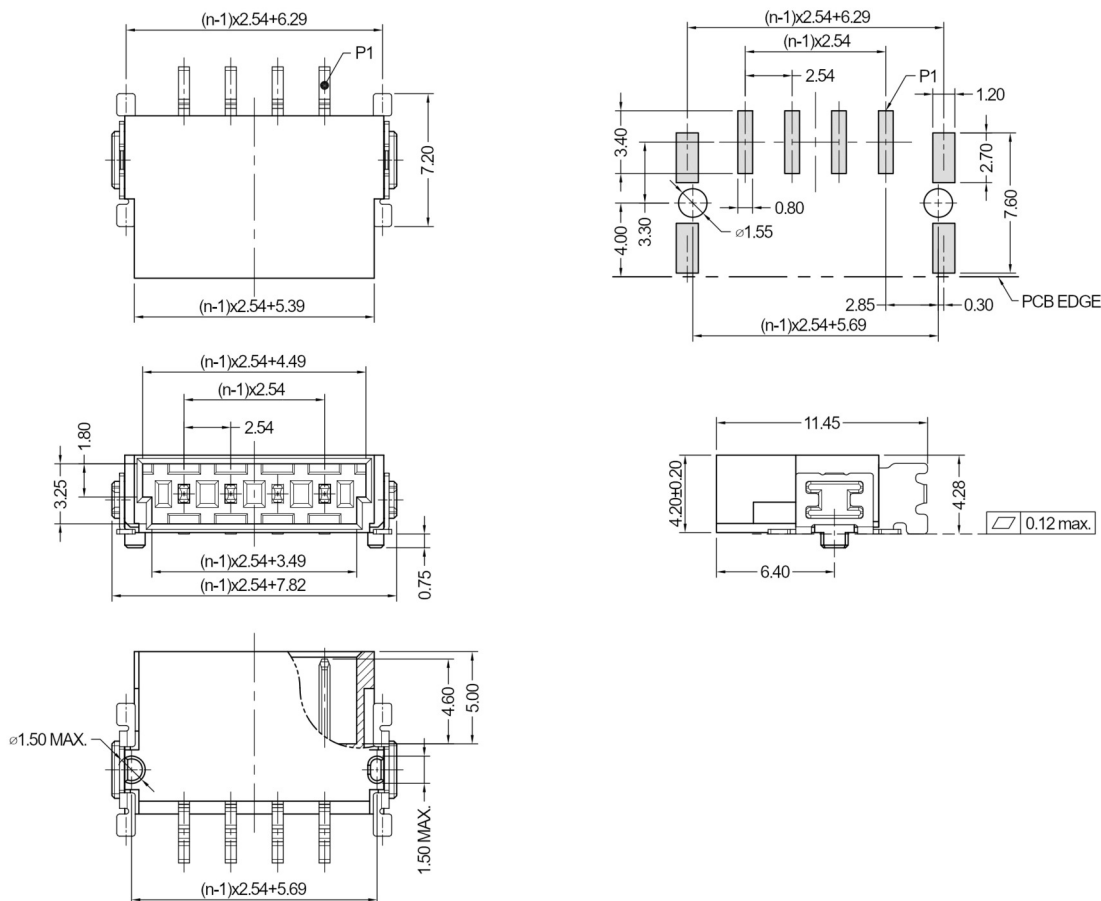
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 10000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1390 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	180 V AC/DC Max.
Nennstrom <i>Current Rating</i>	Siehe Tabelle unten <i>According to table below</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren 260 °C / 10 sec. max. <i>Reflow soldering 260 °C / 10 sec. max.</i>



© W+P PRODUCTS

Gegenstecker / Mating Connectors:  
**9027 9028**

### Recommended P.C.B Layout (Top Side) (PCB Board TOLERANCE ±0.05)



### Series

**9029**

### Contacts\*

**04**

02/03/04/05/06/12

### Plating\*

**60**

60 Sel. Au flash / Sn over Ni  
80 Sel. Au 30µ" / Sn over Ni

### Packing

**TR**

TR Tape & Reel ohne Pick&Place-Pads  
Tape & reel w/o Pick & Place Pads

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# 9027 9028 9029 9030

Nennströme und Bauhöhen  
Current Ratings and Mating Heights

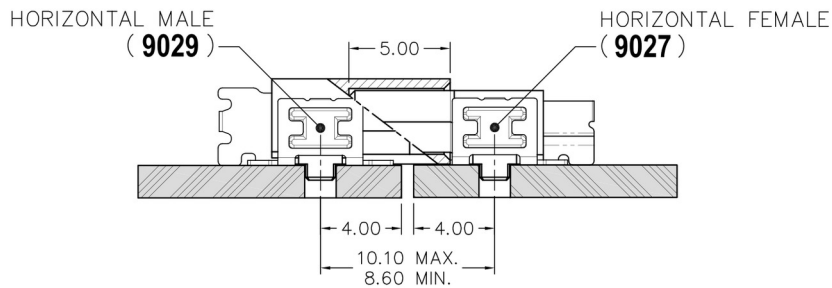
## Nennströme in Abhängigkeit von Polzahl und Gegenstecker

Current Ratings in accordance to Contact Number and Mating Connector

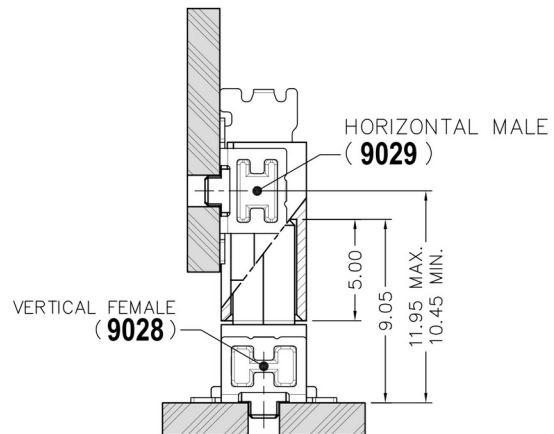
Mating Pair	2 Contacts	3-6 Contacts	12 Contacts
9027-2029	21 A max.	15 A max.	12 A max.
9028-9029	19 A max.	13 A max.	10 A max.
9027-9030	19 A max.	13 A max.	10 A max.
9028-9030	19 A max.	13 A max.	10 A max.

## Bauhöhendiagramme

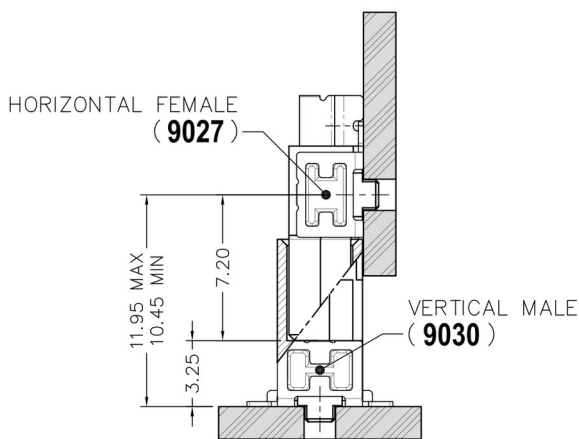
Diagrams of Mating Pairs



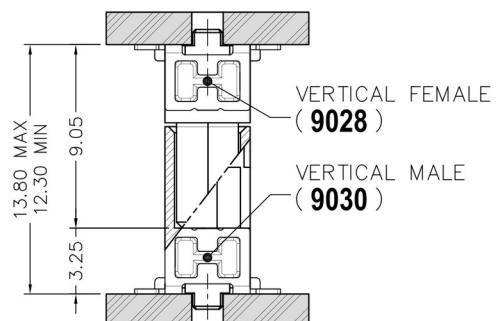
Mating Application - Extender Card



Mating Application - Daughter Card to Motherboard



Mating Application - Daughter Card



Mating Application - Board to Board Stacking

## Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren Fast Profile Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich $T_L$	230°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 4,5min

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature $T_L$	230°C
Duration above $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 4.5min

